

# Кассета Для Мокрой Очистки «Цветок» Из Высокочистого Птфэ, Травильная Стойка Для Одной Пластины, Настраиваемый Держатель Фотошаблона 4 Дюйма

Артикул: PL-CP66



## введение

Кассеты для мокрой очистки «цветок» из высокочистого ПТФЭ обладают исключительной химической стойкостью для обработки полупроводниковых пластин. Эти настраиваемые травильные стойки обеспечивают очистку и обращение с погружением без загрязнения для чувствительных подложек в требовательных лабораторных и промышленных условиях. Свяжитесь с нами для получения индивидуальных решений из фторполимеров.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Очистка полупроводниковых пластин	Погружение кремниевых пластин в последовательности очистки RCA (SC-1 и SC-2) для удаления органических и металлических загрязнений.	Предотвращает перекрестное загрязнение и обеспечивает высокочистую обработку.
Мокрое химическое травление	Точное травление тонких пленок (SiO <sub>2</sub> , Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> ) с использованием ванн плавиковой или фосфорной кислоты при повышенных температурах.	Сохраняет структурную целостность в агрессивных кислотных средах.
Обработка фотошаблонов	Специализированное обращение и очистка фотошаблонов, используемых в литографии, для обеспечения переноса рисунка без дефектов.	Точная нарезка пазов предотвращает повреждение поверхности фотошаблона при контакте.
Изготовление солнечных элементов	Массовая обработка кремниевых пластин для текстурирования и удаления фосфорсилкатного стекла (PSG).	Высокая производительность и долговечность в циклах крупносерийного производства.
Подготовка проводящего стекла	Очистка и подготовка стекла с покрытием ITO/FTO для оптоэлектроники и производства дисплеев.	Минимальные точки контакта предотвращают царапание чувствительных проводящих слоев.
Разработка МЭМС	Обращение со многослойными микроэлектромеханическими системами во время сложных процессов травления жертвенного слоя.	Химическая инертность гарантирует, что чувствительные микроструктуры не будут скомпрометированы.
НИОКР в лабораторном масштабе	Обработка подложек малыми партиями в академических и промышленных исследованиях для разработки новых материалов.	Универсальная настройка позволяет использовать нестандартные формы и размеры подложек.

Параметр	Детали спецификации (Модель: PL-CP66)
Состав материала	100% высокочистый первичный ПТФЭ (политетрафторэтилен)
Макс. рабочая температура	+260°C (Непрерывно)
Мин. рабочая температура	-200°C

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Параметр	Детали спецификации (Модель: PL-CP66)	
<b>Химическая совместимость</b>	Универсальная (pH 0-14); Устойчивость к HF, царской водке, раствору «пирания»	
<b>Стандартный размер подложки</b>	4 дюйма (100 мм) - Настраивается для всех диаметров	
<b>Конфигурация пазов</b>	Доступны варианты для одной пластины или нескольких пластин	
<b>Глубина/ширина паза</b>	Полностью настраивается под толщину подложки и потребности стабильности	
<b>Дизайн ручки</b>	Фиксированная вертикальная, съемная или откидная ручка (Настраиваемая)	
<b>Метод изготовления</b>	Точная механическая обработка на ЧПУ (Нулевое загрязнение при литье)	
<b>Отделка поверхности</b>	Высокая гладкость, обработанная поверхность с низкой пористостью	